第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.重大风险提示
详见公司2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。
3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4.公司全体董事出席董事会会议。
5.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度拟不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股。本次利润分配方案已经董事会审议通过,尚需股东大会审议。
8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	龙芯中科	688047	无

12.公司存托凭证简况
□适用 √不适用
13.联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓钰	李琳
联系地址	北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼	北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼
电话	010-62546668	010-62546668
传真	010-62600826	010-62600826
电子信箱	ir@loongson.cn	ir@loongson.cn

2.报告期公司主要业务简介
2.1主要业务,主要产品或服务情况
公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要通过向客户销售处理器及配套芯片与提供基础软硬件解决方案获取业务收入。
目前,公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、教育等行业领域已获得广泛应用。
(1)处理器及配套芯片产品
公司研制的芯片包括龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。
为扩大龙和的生态圈,2022年开始公司龙芯CPU核心IP开放授权的部分合作伙伴,支持合作伙伴研制基于龙芯CPU核心IP及龙和指令系统的SoC芯片产品。
为支持芯片销售及应用,公司开发了基础服务器及桌面操作系统及浏览器、Java虚拟机、基础库等重要基础软件,持续优化改进。
报告期内,公司研制成功的新产品主要包括面向服务器领域的2K3000系列通用CPU芯片、面向工控等领域的2K0300嵌入式SoC芯片、面向电机驱动领域的1C203可编程MCU芯片等。
主要芯片产品型号如下:
(1)工控类芯片(龙芯1号、龙芯2号)
龙芯1C102是一款嵌入式领域定制的芯片产品,主要面向智能家居以及其他物联网设备。采用龙芯LA132处理器核心,该芯片集成Flash、SPI、UART、I2C、RTC、TSENSOR、VPWM、ADC、GPIO等功能模块,在满足低功耗要求的同时,大幅减少板级成本,具有高稳定、高安全、低成本等特点。产品主要应用于智能门锁类产品、电动助力车、跑步机等场景。
龙芯1C103集成Flash、ATIM、GTIM、ADC、SPI、I2C、UART、RTC等功能模块,可输出带有死区的互补PWM信号,具备驱动能机、有刷电机、无刷电机的原生支持,同时具备常见的通讯模块、产品主要应用于高性价比的常见电机应用场景,如扫地机、跑步机、电磁等。
龙芯1D100是一款超声波水表,热表和气表测量专用MCU芯片,集成CPU、Flash、时间测量单元(TDC)、超声波脉冲发生器、温度测量单元(THSENS)、SPI、I2C、UART、MBUS、段式LCD控制器、ADC、RTC、定管检测、新电检测等功能模块,产品主要应用于智能水表、热表和气表测量专用场景。
龙芯1C201是龙芯1C102的升级版,主要面向电机控制领域,内上集成PWM、Flash、TIM、ADC、SPI、I2C、UART、CAN-FD等功能模块,SRAM取指主频相比前代提升5倍以上,具备驱动能机、有刷电机、无刷电机的原生PWM控制信号支持。产品主要应用于高性价比、高算力要求的高速电机控制场景,如高速吹风机、洗车枪、电锯解等。
龙芯2K0300是一款64位单核SoC芯片,主频0GHz~1.5GHz,基于LA264处理器核,集成DDR3、2D GPU、DVO、PCIe2.0、SATA2.0、USB2.0、USB3.0、GMAC、PCI、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口。产品主要面向工控互联网应用、打印终端、IMC等应用场景。
龙芯2K1000LA是一款64位双核SoC芯片,主频1.0GHz,基于LA264处理器核,集成DDR2/3、PCIe2.0、SATA2.0、USB2.0、DVO等接口。产品主要应用于交换机、边缘网关、工业防火墙、工业平板、智能安检机、终端分布式计算等。
龙芯2K1500是一款64位双核SoC芯片,主频1.0GHz,基于LA264处理器核,集成DDR3、PCIe3.0、SATA3.0、USB2.0接口,提供数据丰富的SPI、CAN、I2C、PWM等小接口,支持vMMC功能。产品主要用于满足轨道网轨扳机下的工控需求。
龙芯2K2000是一款面向服务器及个人计算机领域的龙芯3系列处理器的配套桥片,通过HT3总线与处理器相连,外围接口包括PCIe2.0、GMAC、SATA2.0、USB2.0和其他低速接口,可以满足部分服务器及个人计算机领域应用需求,并为扩展应用提供相应的接口。
龙芯2A000是面向高性能计算机领域的第二代龙芯桥片的配套桥片,通过HT3总线与处理器相连,外围接口包括PCIe3.0、USB3.0、SATA3.0、显示接口为2路HDMI和1路VGA,可直连显示器;内置一个网络PHY,直接提供网络端口输出;片内集成百兆SDIO GPU,采用统一渲染架构,搭配龙芯DDR4显存接口,最大支持16GB显存容量。
其他配套芯片包括LDO电源芯片、DCDC电源芯片、时钟芯片等,主要用于与龙芯系列处理器芯片配套使用。
(2)解决方案
公司基于开放的龙和生态体系,与板卡、整机厂商及基础软件、应用解决方案开发商建立紧密的合作关系,为下游企业提供基于龙芯处理器的各类开发板及软硬件解决方案,并提供完善的技术支持与服务。
报告期内,公司依靠龙芯新一代芯片产品性价比优势和板后展工投和开放市场,着力提升服务器主板OEM能力,强化包括CPU、操作系统、主板在内的“三位一体”能力。在信息化应用领域继续结合特定应用需求,基于龙芯3A6000、3A5000、2K3000、2K0300系列芯片持续优化存储服务器、行业终端、固密产等解决方案,形成系统级整合优势。在存储工控领域,基于3A5000、2K2000、2K1500、2K0300等芯片,和板载安全应用、数据安全管理、加密、应用接口等的产品能力,形成一定的市场份额。在开放市场,充分发挥2P/8P/16P/32P/64P/128P/256P/512P/1024P等多路服务器、优化水表、打印机应用、开发电机驱动解决方案、通过解决方案带动芯片销售,显示出较好的市场前景。
报告期内,公司主营业务基本未发生变化。
2.2主要经营模式
公司经营目前主要采用Fabless模式,公司主要负责芯片的设计工作,形成集成电路设计版图,将晶圆制造、封装、测试等环节委托给相关制造企业生产了一批加工完成,
公司建立了测试实验室,具备一定的筛选测试能力,在提高产品质量控制的同时,缩短芯片测试时间,提高产品交付效率。
公司主要通过向客户销售处理器及配套芯片销售获取收入。
2.3所处行业情况
(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
集成电路设计行业位于集成电路产业链上游,属于技术密集型产业,对技术积发实力要求极高,具有技术门槛高、细分门类众多等特点。集成电路设计能力是一个国家在集成电路领域能力、地位的集中体现。
中国作为全球最大的集成电路市场之一,近年来市场规模持续增长。这一方面得益于消费电子、汽车电子、人工智能等应用的蓬勃发展,另一方面也得益于中国企业在技术创新上的持续投入以及自主创新能力快速提升。中国集成电路产业的快速发展引起了美西方高度关注并采取了一系列打压措施,给产业带来了严峻的挑战,但也因此加速了中国的自主创新和国产替代,在国家政策的大力支持下,中国集成电路在设计、制造、封测等环节均取得了巨大进步,在制造方面,中国在成熟制程领域取得了显著进展,并逐步向更先进节点迈进;在封测环节,中国掌握了复合强制散热技术,并开始应用高密度封装;在设计方面,国产芯片出现在花旁、百解争收的项目,自给率正大幅提升,性能上也日益接近国际先进水平,这其中最具代表性的产品是CPU。
CPU是信息产业中最基础的核心部件,其作为计算机的运算与控制核心,对通用计算处理能力等性能指标有较高的要求,属于集成电路设计中的最高端产品。CPU设计需要具备丰富的知识和高超的技术水平,掌握CPU的指令集、内部结构、时序、功耗、散热、封装、测试等一系列关键技术,需要一批从业经验丰富的高素质工程人员长期持续的研发投入和持续迭代迭代迭代,即使引进国外CPU IP进行设计,国内在工程实践和研发能力方面仍存在较大差距。
CPU设计技术门槛高,研发周期长,且具有规模高的生态壁垒,X86体系起步较早,目前在桌面和服务器市场中占主导地位;ARM生态体系则主要应用于移动平台,在移动芯片市场占主导地位。目前,国内CPU产品处于追赶状态,在性能、生态、应用等方面仍存在较大差距。
近年来,建立独立于X86体系与ARM体系之外的第三套生态系统正成为业界的共识。这一方面是由于美西方对中国CPU企业持续打压,试图通过供应链制裁以及对架构、高端IP授权等方面进行技术封锁限制企业向高端发展;另一方面得益于国内处理器设计和基础软件研发水平的提升,在此背景下,第三套生态体系如Loongarch、RISC-V等正在迅速发展。
RISC-V作为一种开放指令集架构,凭借开源、免费、可扩展等特点,在物联网、工业控制、数据中心等应用领域展现出强大的潜力。Loongarch则在其自主性、先进性、兼容性的解决特性上,在服务器、桌面、终端、工控等通用领域将到日益广泛的应用。伴随着LA软件生态系统的日益完善,我国在主的第三套生态系统正不断壮大。
(2)公司所处的行业地位分析及其竞争优势
“龙芯”系列处理器通用处理器及配套芯片,通过长期积累,公司已拥有一系列自主专利和知识产权,技术优势突出,产品竞争力较强,处于国内通用处理器行业的领先地位。
公司坚持建立独立于X86体系和ARM体系的安全可控的信息技术体系和产业生态,获得自主积分系统龙芯和,掌握CPU IP核的所有授权权利,拥有操作系统和基础软件的核心能力,持续研发及优化包括CPU IP核、GPU IP核、接口IP核等在内的多个自主软/硬护核,不依赖国外技术授权(包括指令系统、IP核等),不依赖境外供应链,从基于自主IP的芯片研发、基于自主工艺的芯片开发、基于自主指令系统的软件生态三个环节提高自主可控度,保障供应链安全的同时基于自主技术构建生态体系。
龙芯基于自主研发构建自主生态的理念越来越得到产业主管部门、产业链合作伙伴和用户的认同。
报告期内,公司研发的龙芯16/32/64核3C3000系列处理器达到Intel第3代至强的水平,走出了一条基于成熟工艺,通过设计优化提升性能的道路。龙芯“三剑客”(3A6000、3C5000、3B6000M/2K2000)和“三朵花”(2K0300、2P0300、3C0203)芯片全面完成设计交付流片,部分芯片已经完成产品化工作进入市场。龙芯新一代产品初步具备了开放市场的性价比竞争力。
报告期内,与指令系统相关的主要开源基础软件社区已经以较高级别和较完善的程度实现对龙芯和的支持,开源软件世界有着重要影响力的Alpine和Debian操作系统社区已经发布完整的龙芯和操作系统发行版或对龙芯和的支持纳入日统版本发布计划,桌面/服务器操作系统社区Deepin、OpenKylin、OpenAnolis、OpenBuilder、OpenCloud已完成对龙芯和的原生支持,基于开源桌面社区Mate、基于开源桌面社区Xfce版本,完成开源桌面标准系统和万台解决器运行时的龙芯和版本开发,基于龙芯和的二次翻译和算力解决基础软件取得突破性进展,龙芯和Linux平台的日积月累迭代,浏览器等基础软件得到进一步的应用迭代。龙芯和软件生态繁荣得到有效破解。
龙芯中科已经成为国内自主CPU的引领者,自主生态的构建者。
(3)报告期内新技术、新产品、新模式的发展情况和未来发展趋势
从技术和产业发展趋势看,信息产业的基础软硬件平台趋于成熟,应用创新方兴未艾,硅平台成为应用创新的重要平台。信息产业的创新从传统CPU和操作系统创新转向包括云计算、大数据、人工智能、物联网等在内的应用创新。一是打通硬件、软件与应用,通过系统优化提升性能,以Intel和微软为代表的平台型企业不断向配系芯片(如Intel的基础架构配置的CPU和AI技术)、应用平台(如微软为支持DPU和AIPT)等拓展,形成系统解决方案,以云端、平端、阿里、华为等代表的系统企业开始积极专用芯片,以期在产品、应用产业的商业模式从平台型企业主导的模式向以硬件为主导的模式转变;二是信息产业的发展由以摩尔定律为代表的技术驱动转向以云计算、大数据、人工智能为代表的应用拉动,把过去需要在操作系统之上用软件实现的算法直接在硬平台上由硬件实现,形成包括CPU、NPU等各种专用加速器;三是随着工艺的升级以及摩尔定律放缓趋势,在不同工艺平台上用硬件实现性能的新的创新平台。
从芯片制造端看,2024年总体上全球半导体市场呈复苏态势,集成电路制造产能利用率有所回升,端内公司国际政治与经济形势明朝发,在不同工艺平台上产能利用率的有效大的差异,具体看,端内在成熟晶圆制造工艺平台,或熟知知工艺平台已经可以满足日集成电路的生产需求;但在先进晶圆制造工艺及先进封装工艺平台上,产能仍然比较紧张;预计未来几年可以得到缓解。
从芯片设计端看,随着地缘政治冲突的持续加剧,美西方对我国高端设计企业不断打压,试图通过供应链制裁以及对架构、高端IP授权等方面进行技术封锁,限制企业向高端发展。在此前提下,国内集成电路产业也更加认同通过自主创新解决“卡脖子”问题,构建自主可控的生态体系已经成为行业共识并正在取得积极进展。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	349,788.34	411,208.90	-14.95	436,834.06
归属于上市公司股东的净资产	209,639.71	354,892.49	-17.26	389,062.08
营业收入	50,425.72	50,569.44	-0.28	73,866.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	50,419.97	50,462.67	-0.08	73,656.18
归属于上市公司股东的净利润	-62,534.71	-32,943.98	不适用	5,175.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,472.53	-44,186.01	不适用	-15,677.76
经营活动产生的现金流量净额	-33,501.01	-41,032.74	不适用	-76,904.62
加权平均净资产收益率(%)	-19.20	-8.84	减少10.46个百分点	1.96
基本每股收益(元/股)	-1.56	-0.82	不适用	0.14
稀释每股收益(元/股)	-1.56	-0.82	不适用	0.14
研发投入占营业收入的比例(%)	106.34	103.47	增加187个百分点	53.93

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	11,999.79	9,968.90	8,819.37	19,647.66
归属于上市公司股东的净利润	-7,480.85	-16,332.15	-10,462.96	-28,258.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,100.04	-17,939.69	-11,028.87	-29,403.93
经营活动产生的现金流量净额	-872.83	-16,892.45	-8,864.34	-6,871.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

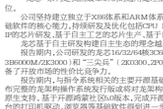
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,516
年度报告披露日前一上月末的普通股股东总数(户)	18,322
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前一上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前一上月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京天童芯源科技有限公司	56,000	86,468,978	21.56	86,316,128	无		境内非国有法人
北京中科算源资产管理有限公司		77,477,539	19.32		无		国有法人
林芝乘亭创业投资管理有限公司-宁波中科百子创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,746,380	28,005,100	6.98	374,668	无		其他
北京工业发展投资管理有限公司	560,000	25,825,846	6.44		无		国有法人
利河信息本管理(横琴)有限公司-横琴利禾博股权投资基金(有限合伙)	-2,005,000	18,044,900	4.50		无		其他
北京天乘芯正科技发展中心(有限合伙)		12,912,923	3.22	12,912,923	无		其他
北京天乘芯源投资管理中心(有限合伙)		12,912,923	3.22	12,912,923	无		其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-1,960,727	10,666,516	2.66		无		其他
北京天乘芯国科技发展中心(有限合伙)		8,838,588	2.20	8,838,588	无		其他
上海鼎鼎百孚投资管理有限公司-宁波鼎鼎邦盛权投资合伙企业(有限合伙)	-1,153,637	8,525,289	2.13		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人胡伟武和前打为天童芯源股东,天童芯源的实际控制人,鼎鼎邦盛和鼎鼎百孚担为一致行动人,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
参考公司2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2025-013

龙芯中科技术股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年5月13日(星期二)上午10:00-11:30;
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/);
● 会议召开方式:上证路演中心视频动播和网络互动;
● 投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@loongson.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日披露公司2024年年度报告和2025年第一季度报告的公告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季度经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年5月13日上午10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频动播结合网络互动方式召开,公司将针对2024年度以及2025年第一季度经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年5月13日(星期二)10:00-11:30
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频动播和网络互动
三、参加人员
董事长、总经理:胡伟武
董事会秘书:李晓钰
财务总监:曹晓财
独立董事:吴辉、肖利民
如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年5月13日(星期二)10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次投资者说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question?Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@loongson.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券事务办公室
电话:010-62546668
邮箱:ir@loongson.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2025-010

龙芯中科技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“本次发行”)的申请于2021年12月17日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕164号文同意注册。本次发行数量为4,100.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币60.06元/股,募集资金总额为246,246.00万元,扣除发行费用74,252.11万元,实际募集资金净额为241,993.89万元。
以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天职业字[2022]35349号)。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:
单位:人民币,万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金额
1	先进制程芯片研发及产业化项目	125,760.45	85,000.00
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	105,426.45	36,993.89
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		351,186.90	241,993.89

截至2025年3月31日,募集资金使用情况如下:
单位:人民币,万元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金额	累计投入募集资金额	累计投入进度
1	先进制程芯片研发及产业化项目	85,000.00	76,862.83	90.43%
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	36,993.89	25,126.77	67.92%
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00	100%

三、本次募投项目延期的情况
(一)本次募投项目延期的具体情况
根据公司所处行业发展变化及公司发展战略、业务布局和实际生产经营的需要,为了提高募集资金使用效率,公司拟对先进制程芯片研发及产业化项目和高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目的实施进度进行调整。
截至2025年3月31日,先进制程芯片研发及产业化项目已累计投入募集资金76,862.83万元,募集资金使用进度为90.43%;高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目已累计投入募集资金25,126.77万元,募集资金使用进度为67.92%。根据公司募投项目实际情况,经过谨慎的研究论证,公司拟调整募投项目实施进度,拟将募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年6月调整至2026年6月。
本次变更前后具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	先进制程芯片研发及产业化项目	2025年6月	2026年6月
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	2025年6月	2026年6月
3	补充流动资金	/	/

(二)本次募投项目延期的原因
随着全球科学技术领域的飞速发展,特别是中国在人工智能领域的快速崛起,大量的AI应用不断涌现,下游终端客户与设备厂商对芯片产品的需求提出了更高的要求。集成电路行业不仅受到以CPU为主的通用算力,专用算力的需求也越来越广泛。为适应市场需求的变化与行业技术发展的趋势,公司特别新密集推出发展规划的步伐,决定在募投项目研发的新芯片产品中增加AI算力,提高产品竞争力,为人工智能应用场景提供算力,高效地应用新算法,提高性能上扩展AI指令及其他扩展指令集,以应用场景为导向,在满足通用计算性能的基础上,提高对于AI应用的支持能力,在“结构优化一代”的芯片的研发中做到了突破性进展,新研的新一代高性能处理器核,在处理器核、内核、内存、外设、接口、安全、时钟、电源等方面进行了全面的升级,在保持原有通用计算性能的基础上,大幅提升了AI应用的支持能力,并且在保证功耗、面积、成本、可靠性等方面进行了全面的优化,使得新的处理器核在通用CPU和集成AI处理能力变得更为灵活,因此公司决定增加流片的AI计算能力,在该款芯片中集成高性能通用计算用处理器以及专用的AI核心,满足未来AI处理需求。
公司在“国内集成电路设计及系统研发项目”中优先安排的,与龙芯CPU配套的显卡应用以及服务器AI应用芯片2K3000 SoC,在过去一年的研制中取得显著进展,于2024年上半年完成设计交付流片,2024年底回片,测试顺利,符合设计预期,截至报告期末,2K3000流片成功,为进一步提高产品竞争力,强化通用图形处理器与公司主营通用处理器硬件配套,公司决定在龙芯第二代通用图形处理器4核基础上展开新一轮芯片优化,研制性强性通用图形处理器,通过设计优化大幅提高单位面积算力性能,国大幅提升算力密度,尤其是提高推理能力,并将通用图形处理器中核心在龙芯自主指令系统上实现兼容性,以期在未来实现龙芯VA1000中应用。
公司结合市场的快速变化,综合考虑成本费用,为了更好地发挥募集资金的使用效益,根据目前公司募投项目的实际建设情况,经过谨慎的研究论证,决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体情况如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕646号文),同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,100.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币60.06元/股,募集资金总额为246,246.00万元,各项发行费用总额为74,252.11万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。
公司实际收到的募集资金金额243,931.29万元于2022年6月21日全部到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天职业字[2022]35349号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:
单位:人民币,万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金额
1	先进制程芯片研发及产业化项目	125,760.45	85,000.00
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	105,426.45	36,993.89
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		351,186.90	241,993.89

截至2025年3月31日,募集资金使用情况如下:
单位:人民币,万元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金额	累计投入募集资金额	累计投入进度
1	先进制程芯片研发及产业化项目	85,000.00	76,862.83	90.43%
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	36,993.89	25,126.77	67.92%
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00	100%

三、本次募投项目延期的情况
(一)本次募投项目延期的具体情况
根据公司所处行业发展变化及公司发展战略、业务布局和实际生产经营的需要,为了提高募集资金使用效率,公司拟对先进制程芯片研发及产业化项目和高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目的实施进度进行调整。
截至2025年3月31日,先进制程芯片研发及产业化项目已累计投入募集资金76,862.83万元,募集资金使用进度为90.43%;高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目已累计投入募集资金25,126.77万元,募集资金使用进度为67.92%。根据公司募投项目实际情况,经过谨慎的研究论证,公司拟调整募投项目实施进度,拟将募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年6月调整至2026年6月。
本次变更前后具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	先进制程芯片研发及产业化项目	2025年6月	2026年6月
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	2025年6月	2026年6月
3	补充流动资金	/	/

(二)本次募投项目延期的原因
随着全球科学技术领域的飞速发展,特别是中国在人工智能领域的快速崛起,大量的AI应用不断涌现,下游终端客户与设备厂商对芯片产品的需求提出了更高的要求。集成电路行业不仅受到以CPU为主的通用算力,专用算力的需求也越来越广泛。为适应市场需求的变化与行业技术发展的趋势,公司特别新密集推出发展规划的步伐,决定在募投项目研发的新芯片产品中增加AI算力,提高产品竞争力,为人工智能应用场景提供算力,高效地应用新算法,提高性能上扩展AI指令及其他扩展指令集,以应用场景为导向,在满足通用计算性能的基础上,提高对于AI应用的支持能力,在“结构优化一代”的芯片的研发中做到了突破性进展,新研的新一代高性能处理器核,在处理器核、内核、内存、外设、接口、安全、时钟、电源等方面进行了全面的升级,在保持原有通用计算性能的基础上,大幅提升了AI应用的支持能力,并且在保证功耗、面积、成本、可靠性等方面进行了全面的优化,使得新的处理器核在通用CPU和集成AI处理能力变得更为灵活,因此公司决定增加流片的AI计算能力,在该款芯片中集成高性能通用计算用处理器以及专用的AI核心,满足未来AI处理需求。
公司在“国内集成电路设计及系统研发项目”中优先安排的,与龙芯CPU配套的显卡应用以及服务器AI应用芯片2K3000 SoC,在过去一年的研制中取得显著进展,于2024年上半年完成设计交付流片,2024年底回片,测试顺利,符合设计预期,截至报告期末,2K3000流片成功,为进一步提高产品竞争力,强化通用图形处理器与公司主营通用处理器硬件配套,公司决定在龙芯第二代通用图形处理器4核基础上展开新一轮芯片优化,研制性强性通用图形处理器,通过设计优化大幅提高单位面积算力性能,国大幅提升算力密度,尤其是提高推理能力,并将通用图形处理器中核心在龙芯自主指令系统上实现兼容性,以期在未来实现龙芯VA1000中应用。
公司结合市场的快速变化,综合考虑成本费用,为了更好地发挥募集资金的使用效益,根据目前公司募投项目的实际建设情况,经过谨慎的研究论证,决定调整研发计划,增强两个募集资金投资项目的合理性。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据募投项目实施情况做出的审慎决定,本次变更募项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2025-011

龙芯中科技术股份有限公司关于使用基本存款账户支付劳务费项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用基本存款账户支付劳务费项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》,公司根据募投项目实施的具体情况,使用基本存款账户支付劳务费项目人员及材料费用并定期以募集资金等额置换,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2021年12月17日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕164号文同意注册。本次发行数量为4,100.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币60.06元/股,募集资金总额为246,246.00万元,各项发行费用总额为74,252.11万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。
以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天职业字[2022]35349号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:
单位:人民币,万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金额
1	先进制程芯片研发及产业化项目	125,760.45	85,000.00
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	105,426.45	36,993.89
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		351,186.90	241,993.89

截至2025年3月31日,募集资金使用情况如下:
单位:人民币,万元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金额	累计投入募集资金额	累计投入进度
1	先进制程芯片研发及产业化项目	85,000.00	76,862.83	90.